

SP240-Series

SP240 Series는 고온용 Solder paste로 SMT공정에 적용이 가능하고, 고온의 reflow 조건에서 우수한 결과를 얻을 수 있는 제품이다.

Application

- SMT와 Die attach 공정 및 고온 동작 환경을 요하는 반도체 장비 업종에서 사용 가능
- Printing 공정에 최적화 됨

Features

- Halogen Free의 플렉스를 사용하고 있음
- 연속 프린팅 (Printing)시 경시변화가 적고, 매우 일관된 프린팅 (Printing) 성능
- 고온 리플로우(Reflow)에서도 우수한 내열성
- 탁월한 젖음성(Wetting performance) 및 보이드(Void) 최소화
- 프린팅 (Printing) 후 슬럼프(Slump)현상이 적어 솔더링(Soldering)의 신뢰성이 높음
- 솔더볼(Solder ball) 발생이 적은 뛰어난 환원 시스템

Information

합금 : Sn3.0Ag0.5Cu / Sn0.7Cu (고객 요청 반영 가능)

입자크기 : Type 4 (20~38um),Type 5 (15~25um),Type 6 (5~15um)

포장사양 : 500g , 고객 요청 반영 가능

Properties

Spec.	Unit	Value	Measured
Color	-	Gray	Visual
Activity Level	-	ROLO	IPC J-STD-004B
Specific gravity	-	7.4	-
Thixotropic Index (TI)	-	0.4~0.7	MALCOM
Viscosity @ 25°C	Pa.S	LV (40~80) MV (80~140) HV (140~ 230)	MALCOM(10rpm)
Thermal Conductivity	W/mK	63	Laser Flash Diffusivity

- 고객 공정조건에 따른 변경 가능 (금속 함량 및 점도)

Working Time

Spec.	Unit	Value	Measured
Work life	Hour	< 8hrs	-
Shelf life	Month	6month	0-10°C

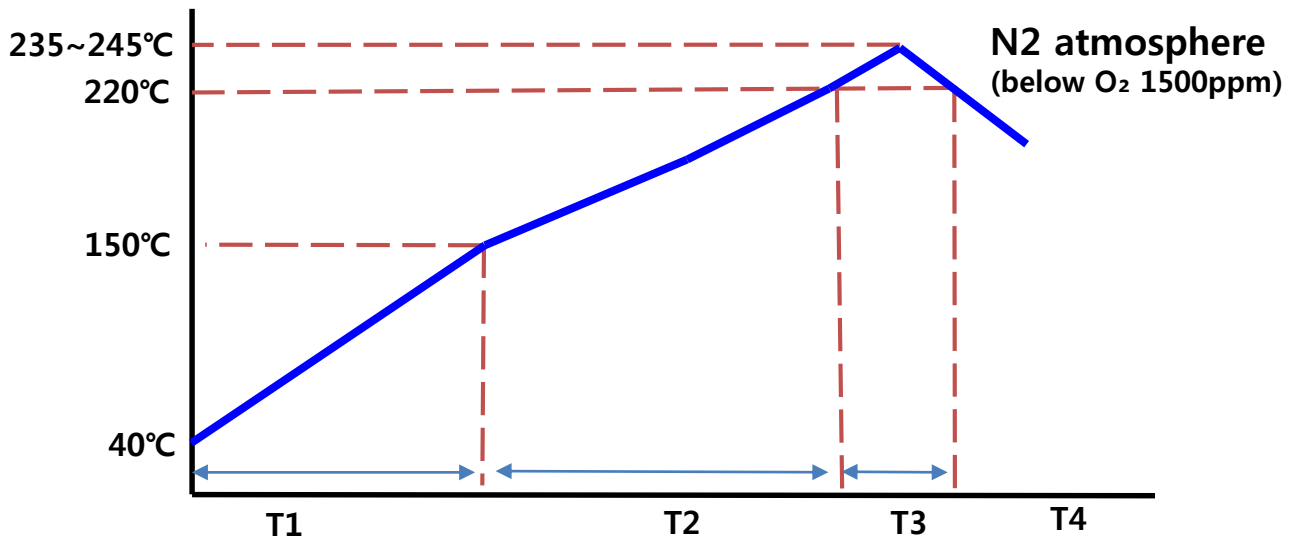
사용방법
1) 해동

- 작업 2시간 전에 냉장고에서 꺼내, 개봉하지 않은 채로 상온방치
냉장상태로 개봉 시 결로 현상에 의한 solder ball 발생의 원인이 될 수 있음.
- 실온과 비슷한 온도 (20~25°C)가 되었을 때 개봉하여 사용 할 것.

2) 교반

- 수동 교반 권장(1min ~ 2min)
지나친 교반 시 페이스트 물성이 변할 수 있음.

조건(Spec.)	속도(RPM)	시간(Sec.)
자동 교반(Jar)	500	30~60

Reflow Profile


Zone	T1	T2	T3	T4	Peak Temp.
Type	Raising	Preheat 1	Soldering	Cooling	240+/-5°C
Temp(°C)	40~150	150~220	220°C 이상	220°C이하	
Time(sec)	1~2°C/sec	60~120	40~90	2°C/sec	